



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ

BGA/CSP шарики припоя



Шарики припоя предназначены для восстановления выводов и ремонта (реболлинга) ИМС в корпусах BGA, μ BGA, CSP, Flip Chip.

Параметры BGA/CSP шариков припоя

Номер по каталогу	Тип ИМС BGA	Сплав	Диаметр, мкм	Точность диаметра, мкм	Сферичность, %	Количество шариков в упаковке, шт.
BGA BALLS-SN63-500-500K	PBGA	Sn63/Pb37	500	10	0,2	500 000
BGA BALLS-SN63-550-500K	PBGA	Sn63/Pb37	550	15	0,2	500 000
BGA BALLS-SN63-600-500K	PBGA	Sn63/Pb37	600	20	0,2	500 000